

Docket No.: GR 98 P 1075

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as First Class Mail in an envelope addressed to the Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, on the date indicated below.

By: Manfred Fries Date: February 11, 2004

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applic. No. : 09/627,181 Confirmation No.: 1252
Inventor : Manfred Fries et al.
Filed : July 27, 2000
Title : Smart Card Module for Biometric Sensors
TC/A.U. : 2876
Examiner : Ashik Kim
Customer No.: 24131

CLAIM FOR PRIORITY

Hon. Commissioner for Patents
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Claim is hereby made for a right of priority under 35 U.S.C. §119, based upon German Patent Application No. 198 03 020.7, filed January 27, 1998.

A certified copy of the above-mentioned foreign patent application was forwarded to the Patent Office on May 15, 2003. However, the priority document was not received in the Patent Office. Consequently, the Examiner stated in an Office action dated November 4, 2003, that applicants had not yet filed a certified copy of the priority document. Applicants submitted a response on November 12, 2003 corroborating the mailing of the priority document on May 15, 2003.

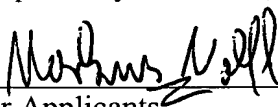
In view of the foregoing, counsel has requested another priority document from applicants. Enclosed herewith are:

- A certified copy of German priority application No. 198 03 020.7. It is to be noted that the filing date on the cover sheet of said priority application is incorrectly listed

as November 27, 1998. That error was then corrected by the German Patent Office and another priority document bearing the original seal of the German Patent Office but without the actual application papers was issued with the correct filing date of January 27, 1998.

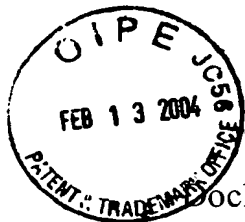
- Cover Sheet bearing the original seal of the German Patent Office for the above-mentioned priority application with the correct filing date of January 27, 1998. A statement with regard to the correction of the filing date is outlined therein.
- Certified translation of the cover sheet of both documents submitted herewith.

Respectfully submitted,


For Applicants

MARKUS NOLFF
REG. NO. 37,006

Date: February 11, 2004
Lerner and Greenberg, P.A.
Post Office Box 2480
Hollywood, FL 33022-2480
Tel: (954) 925-1100
Fax: (954) 925-1101
/bb



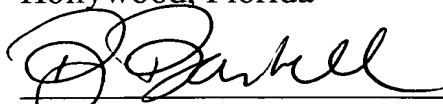
ocket No.: GR 98 P 1075

CERTIFICATION

I, the below named translator, hereby declare that: my name and post office address are as stated below; that I am knowledgeable in the English and German languages, and that I believe that the attached text is a true and complete translation of the cover sheet of the Certificate of Priority for German priority document No. 198 03 020.7, filed January 27, 1998.

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Hollywood, Florida



Birgit Bartell

February 11, 2004

Lerner & Greenberg, P.A.
P.O. Box 2480
Hollywood, FL 33022-2480
Tel.: (954) 925-1100
Fax.: (954) 925-1101



FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

Seal

**Certificate of Priority of the Filing of
a Patent Application**

File Number	198 03 020.7
Filing Date	November 27, 1998
Applicant/Owner	Siemens Aktiengesellschaft, München/DE
Title	Chip Card Module for Biometric Sensors
IPC:	G 06 K 19/073

The attached document is a correct and true copy of the original papers of this patent application.

**Munich, December 3, 2003
German Patent and Trademark Office
The President
On behalf of**

Signature

Letang

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 198 03 020.7

Anmeldetag: 27. November 1998

Anmelder/Inhaber: Siemens Aktiengesellschaft, München/DE

Bezeichnung: Chipkartenmodul für biometrische Sensoren

IPC: G 06 K 19/073

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 3. Dezember 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag



Letang

5 Chipkartenmodul für biometrische Sensoren

Die Erfindung betrifft ein Chipkartenmodul für biometrische
10 Sensoren, die in Chipkarten eingesetzt werden.

In Bereichen, wo es auf die eindeutige Identifikation von
Personen ankommt, werden vermehrt Sensoren eingesetzt, die
mit Hilfe biometrischer Verfahren arbeiten und individuelle
15 biologische Merkmale einer Person, beispielsweise einen Fin-
gerabdruck, erkennen können. Fingerabdrucksensoren können
beispielsweise zur Überprüfung der Zugangsberechtigung einer
Person in Sicherheitsbereichen von Banken, Forschungslabors,
militärischen Einrichtungen etc. verwendet werden, wobei in
20 Abhängigkeit des Überprüfungsergebnisses der Zugang zu Räu-
men, Computern etc. freigegeben wird oder nicht.

Es ist bekannt, als Fingerabdrucksensoren Sensorchips zu ver-
wenden, welche an Geräten oder Wänden derart angeordnet sind,
daß ein Finger aufgelegt werden kann. Weiterhin sind Chipkar-
25 ten in der Form von Eintrittsberechtigungskarten oder Bankau-
tomatenkarten bekannt, welche in Verbindung mit einer einzu-
gebenden Geheimnummer eine Tür öffnen bzw. den Zugriff auf
ein Bankkonto erlaubt. Derartige Chipkarten arbeiten jedoch
30 nicht mit biometrischen Sensoren und erfüllen nicht die höch-
sten Sicherheitsanforderungen gegen unberechtigte Verwendung.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Chipkar-
tenmodul für biometrische Sensoren zu schaffen, welche für
35 den Einbau in Chipkarten verwendbar ist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind in den weiteren Ansprüchen beschrieben.

5 Bei dem erfindungsgemäßen Chipkartenmodul ist der Sensorchip auf einem platten- oder folienartigen Träger befestigt, der elektrisch leitende Bereiche aufweist, die einerseits mit dem Sensorchip und andererseits mit elektrischen Anschlüssen der Chipkarte verbunden sind. Der Träger weist im Bereich des
10 Sensorchips mindestens ein durchgehendes Fenster auf. Weiterhin ist der Sensorchip derart am Träger befestigt, daß die aktive Struktur des Sensorchips zum Träger hin gerichtet ist und im Bereich des Fensters liegt, so daß sie durch das Fenster des Trägers hindurch zugänglich ist.

15 Das erfindungsgemäße Chipkartenmodul ermöglicht es, biometrische Sensorchips in Chipkarten einzubauen. Hierdurch kann die Sicherheit konventioneller Chipkarten nochmals erhöht werden. Die Chipkarte wird üblicherweise so weit in ein
20 Auslesegerät eingesteckt, daß das Fenster mit dem Sensorchip noch frei zugänglich ist. Vom Auslesegerät erhält das Chipkartenmodul dann die zum Erfassen des Fingerabdrucks erforderliche Energie, wobei die Daten vom Sensorchip ggf. zu einem ebenfalls in der Chipkarte integrierten Halbleiter-Chip weitergegeben werden, der als Auswerteeinrichtung dient. Derartige Chipkarten können sowohl als kontaktlose als auch als kontaktbehaftete Chipkarten ausgeführt werden. Bei den kontaktlosen Chipkarten werden die Energie und die Daten über induktive/kapazitive Kopplung zugeführt.

30 Besonders vorteilhaft ist, daß das erfindungsgemäße Chipkartenmodul in gleicher Weise, wie dies in der Chipkartentechnik üblich ist, am Band fertig montiert und getestet werden kann und erst im Rahmen eines abschließenden Arbeitsgangs in die vorbereitete Chipkarte eingesetzt werden
35 kann. Zum Einsetzen in die Chipkarte kann die übliche Montagetechnik verwendet werden, wie sie bei sogenannten Kom-

bichipmodulen, d.h. bei gleichzeitig kontaktlosen als auch Kontaktbehafteten Chipmodulen, verwendet wird. Die elektrische Funktion des Sensorchips bzw. des gesamten Chipmoduls kann schon vor dem Einsetzen in die Chipkarte getestet werden. Die Integration im Herstellprozeß ist dementsprechend leicht und kostengünstig.

Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform ist der Sensorchip in mehrere Einzelsegmente unterteilt, die jeweils im Bereich eines eigenen Fensters des Trägers liegen. Die Aufteilung des Sensorchips in mehrere Einzelsegmente hat den Vorteil, daß die Bruchgefahr des relativ großen und dadurch bruchempfindlichen Sensorchips, der im Falle eines Fingerabdrucksensors erforderlich ist, bedeutend verringert wird.

Vorteilhafterweise ist das Chipkartenmodul in den Randbereichen des Trägers mit einem flexiblen Kleber mit dem Chipkartenmaterial verklebt. Hierdurch kann der schädliche Einfluß von Biegespannungen von der Chipkarte auf das Chipkartenmodul verringert werden.

Gemäß einer zweckmäßigen Ausführungsform der Erfindung bestehen die elektrisch leitenden Bereiche des Chipkartenmoduls zwischen den elektrischen Anschlüssen der Chipkarte und dem Sensorchip zumindest zum Teil aus mäanderförmig geführten Leiterbahnen. Derartige mäanderförmig geführte Leiterbahnen bieten eine entsprechende Flexibilität, um Biegespannungen bei großflächigen Sensorchips aufzunehmen, ohne daß die elektrischen Verbindungen beschädigt werden.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnungen beispielhaft näher erläutert. In diesen zeigen:

Figur 1 : einen Querschnitt des erfindungsgemäßen Chipkartenmoduls, das in eine entsprechende Vertiefung in einer Chipkarte eingesetzt ist,

Figur 2 : eine schematische perspektivische Ansicht des
Chipkartenmoduls schräg von oben,

Figur 3 : eine Draufsicht auf eine mäanderförmig geführte
Leiterbahn, die sich vom Außenanschluß des
Chipkartenmoduls zum Sensorchip erstreckt, und

Figur 4 : eine schematische Draufsicht auf ein
Chipkartenmodul mit einem in vier Einzelsegmente
unterteilten Sensorchip und einem vier
entsprechende Fenster aufweisenden Träger.

Aus Figur 1 ist ein Ausschnitt einer Chipkarte 1 mit einer
von ihrer Oberfläche 2 her eingebrachten Vertiefung 3 er-
sichtlich, in die ein Chipkartenmodul 4 eingesetzt ist.

Das Chipkartenmodul 4 weist einen platten- oder folienartigen
Träger 5 auf, der aus einer Epoxyschicht 6, einer oberen lei-
tenden Schicht 7 und unteren leitenden Bereichen 8 besteht.
In der Mitte des Trägers 5 ist eine durchgehende Aussparung
vorgesehen, welche ein rechteckiges Fenster 9 bildet.

Auf der Unterseite des Trägers 5 ist ein Sensorchip 10 ange-
ordnet, welches eine obere aktive Fläche 11 aufweist. Diese
aktive Fläche 11 ist als Sensorfläche ausgebildet, welche in
der Lage ist, den Fingerabdruck eines auf die aktive Fläche
11 aufgelegten Fingers zu erkennen und die Struktur des Fin-
gerabdrucks in Form von elektrischen Impulsen an eine nicht
näher dargestellte Auswerteeinheit weiterzugeben. Der Sensor-
chip 10 ist etwas größer als das Fenster 9 und unmittelbar
unterhalb des Fensters 9 angeordnet, so daß die aktive Fläche
11 zum Fenster 9 hin gerichtet ist und der Sensorchip 10 an
den Randbereichen des Trägers 5 neben dem Fenster 9 befestigt
werden kann. Die elektrischen Anschlüsse des Sensorchips 10
sind über Chipkontaktierungsstellen 12 mit zugeordneten lei-
tenden Bereichen 8 des Trägers 5 verbunden, wobei sich diese
Chipkontaktierungsstellen 12 im Randbereich neben dem Fenster

9 befinden. Die elektrische Verbindung zwischen Chipkartenmodul 4 und Leiterbahnen 13 der Chipkarte 1 erfolgt über äußere Anschlüsse 14, welche sich zwischen den Leiterbahnen 13 der Chipkarte 1 und den leitenden Bereichen 8 des Chipkartenmoduls 4 befinden.

Zwischen den äußeren Anschlüssen 14 und den Chipkontaktierungsstellen 12 befindet sich weiterhin ein Versteifungselement 15 in der Form eines steifen Ringes, der von unten her auf den Träger 5 aufgesetzt ist.

Das gesamte Chipkartenmodul 4 wird mittels eines flexiblen Klebers 16 in einem erhöhten Randbereich der Vertiefung 3 festgeklebt. Dieser flexible Kleber 16 weist eine ausreichende Flexibilität und Dicke auf, so daß er in der Lage ist, bei einer Verbiegung der Chipkarte 1 entsprechend nachzugeben. Hierbei wird vermieden, daß das relativ steife Chipkartenmodul 4 und insbesondere der Sensorchip 10 beschädigt wird.

Um zu verhindern, daß entsprechende Biegespannungen von den äußeren Anschlüssen 14 über die leitenden Bereiche 8 auf die Chipkontaktierungsstellen 12 und von dort auf den Sensorchip 10 übertragen werden, ist es möglich, die leitenden Bereiche 8 als mäanderförmig verlaufende Leiterbahnen auszubilden, von denen ein Beispiel als Draufsicht in Figur 3 dargestellt ist.

Figur 2 zeigt in schematischer, perspektivischer Ansicht das Chipkartenmodul 4 von Figur 1. Die obere leitende Schicht 7 bildet einen um das Fenster 9 herum umlaufenden Masserahmen. Bei diesem Ausführungsbeispiel ist im Träger 4 ein einziges Fenster 9 vorgesehen, das ausreichend groß ist, um einen gesamten Fingerabdruck erfassen zu können.

In Figur 4 ist eine schematische Draufsicht auf eine alternative Ausführungsform der Erfindung gezeigt, bei welcher der Sensorchip 10 in vier Segmente 10a, 10b, 10c, 10d unterteilt ist. Diese Segmente 10a, 10b, 10c, 10d sind im gezeigten Aus-

führungsbeispiel quadratisch und gleich groß, wobei ihre Außenkonturen gepunktet eingezeichnet sind.

Bei Verwendung eines derartigen viergeteilten Sensorchips 10 ist auch das Fenster 9 des Trägers 5 viergeteilt, d.h. das Fenster 9 weist vier Einzelfenster 9a, 9b, 9c, 9d auf, die ebenfalls quadratisch und derart angeordnet sind, daß sie insgesamt ein großes Quadrat ergeben. Die Einzelfenster 9a, 9b, 9c, 9d sind durch Stege 17 des Trägers 5 voneinander getrennt, die zusammen ein zentrales Kreuz bilden. Die Stege 17 dienen zur Befestigung der Segmente 10a, 10b, 10c, 10d des Sensorchips 10. Durch die Segmentierung des Sensorchips 10 ist eine gewisse Flexibilität des Sensorchips 10 gewährleistet, so daß die Bruchgefahr bei einer Verbiegung der Chipkarte 1 verringert wird.

Wird ein Finger auf die Fenstersegmente 9a, 9b, 9c, 9d aufgelegt, werden die Fingerabdrucklinien, welche aufgrund der Stege 17 lediglich unterbrochen erfaßt werden können, auf elektronische Weise ergänzt, so daß ein Fingerabdruck auf die gleiche Weise ausgewertet werden kann, als wenn die Stege 17 nicht vorhanden wären.

Patentansprüche

1. Chipkartenmodul für biometrische Sensoren zum Einbau in
5 Chipkarten, mit mindestens einem Sensorchip (10) als Sensor,
einem platten- oder folienartigen Träger (5), an dem der Sen-
sorchip (10) befestigt ist und der elektrisch leitende Berei-
che (8) aufweist, die einerseits mit dem Sensorchip (10) und
10 andererseits mit elektrischen Anschlüssen (14) der Chipkarte
(1) verbunden sind, wobei der Träger (5) im Bereich des Sen-
sorchips (10) mindestens ein durchgehendes Fenster (9) auf-
weist und der Sensorchip (10) derart am Träger (5) befestigt
ist, daß die aktive Fläche (11) des Sensorchips (10) zum Trä-
ger (5) hin gerichtet ist und im Bereich des Fensters (9)
15 liegt, so daß sie durch das Fenster (9) des Trägers (5) hin-
durch zugänglich ist.
2. Chipkartenmodul nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**,
daß der Sensorchip (10) in mehrere Einzelsegmente (10a, 10b,
20 10c, 10d) unterteilt ist, die jeweils im Bereich eines eige-
nen Fenstersegments (9a, 9b, 9c, 9d) des Trägers (5) liegen.
3. Chipkartenmodul nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekenn-
zeichnet**, daß das Chipkartenmodul in den Randbereichen des
Trägers (5) mit einem flexiblen Kleber (16) mit dem Chipkar-
tenmaterial verklebt ist.
4. Chipkartenmodul nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß die elektrisch leitenden Bereiche
30 (8) des Chipkartenmoduls zwischen den elektrischen Anschlüs-
sen (14) der Chipkarte (1) und dem Sensorchip (10) zumindest
zum Teil aus mäanderförmig geführten Leiterbahnen bestehen.

Zusammenfassung

5

Chipkartenmodul für biometrische Sensoren

10 Bei einem Chipkartenmodul für biometrische Sensoren zum Ein-
bau in Chipkarten weist ein Träger (5) im Bereich eines Sen-
sorchips (10) mindestens ein durchgehendes Fenster (9) auf.
Der Sensorchip (10) ist derart am Träger (5) befestigt, daß
die aktive Fläche (11) des Sensorchips (10) zum Träger (5)
15 hin gerichtet ist und im Bereich des Fensters (9) liegt, so
daß sie durch das Fenster (9) des Trägers (5) hindurch zu-
gänglich ist.

20 (Figur 1

1)

